

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-016

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年3月30日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

#### 一、申请综合授信额度情况概述

为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及公司全资、控股子公司于2018年度拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币1亿元，期限不超过1年。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

#### 二、对公司的影响

本次向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司及子公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日